

資訊工程學系開課時序表

103學年度入學新生適用

本系學生畢業時至少應修滿 133 學分，包括

通識 40 學分

專業必修：院基礎課程 12 學分、跨領域就業導向學程至少 18 學分、系核心學程 23 學分。

專業選修：R1網路、多媒體與晶片應用基礎學程 25 學分。

R2晶片應用進階學程 21 學分、

R3網路與多媒體進階學程 21 學分。

主修領域：系核心學程+專業選修學程：69 學分(有2項主修領域，請參考課程說明第7點)

104年5月20日本系103學年度第2學期第4次系課程會議討論  
 105年11月10日本系105學年度第1學期第2次系課程會議修訂  
 105年11月23日科技學院105學年度第1學期第1次院課程會議審議  
 105年11月30日本校105學年度第1次校課程會議

	一年級	上學期		下學期		二年級	上學期		下學期		三年級	上學期		下學期		四年級	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數
院基礎課程	微積分(一)	3	3																	
	計算機概論	3	3																	
	基礎電學			3	3															
	微積分(二)			3	3															
跨領域就業導向學程一(資訊技術應用)						網頁程式設計	3	3			資料庫管理系統			3	3	專題(二)	3	3		
						資訊應用檢定			3	3	專題(一)			3	3					
						JAVA程式設計			3	3										
跨領域就業導向學程二(健康生活科技)						健康生活科技創意	3	3			跨科技領域知識(二)	3	3			健康生活產業經營管理實務	3	3		
						跨科技領域知識(一)	3	3			跨科技領域知識(三)			3	3	專題(二)	3	3		
						網頁程式設計	3	3			專題(一)			3	3					
						資訊應用檢定			3	3	資料庫管理系統			3	3					
						JAVA程式設計			3	3										
資訊工程學系核心課程	計算機程式設計	3	3			資料結構(一)	3	3												
	物件導向程式設計			3	3	電腦網路概論	3	3												
	數位系統導論			3	3	工程數學	3	3												
	數位系統實習			1	3	電子學	3	3												
						電子學實習	1	3												
專業必修小計	院基礎課程：12 學分。跨領域就業導向學程：至少18 學分(資訊技術應用類、健康生活科技應用類二選一)。資訊工程學系核心課程：23 學分。共 53 學分。																			

	二年級		三年級		四年級							
	上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期						
R1網路、多媒體與晶片應用基礎學程	資料結構(二)	3 3	線性代數	3 3								
	離散數學	3 3	軟體工程	3 3								
	機率統計	3 3	計算機組織	3 3								
			計算機組織實習	1 3								
			作業系統概論		3 3							
			系統程式		3 3							
R2晶片應用進階學程(任選7門)	視窗程式設計	3 3	JAVA程式設計認證	3 3								
			影像處理	3 3								
			硬體描述語言	3 3								
			微處理機實務		3 3							
			新產品開發管理與專利保護	3 3								
			超大型積體電路導論	3 3								
			書報討論	2 2								
			數位訊號處理		3 3							
			FPGA數位雛型設計		3 3							
R3網路與多媒體進階學程(任選7門)	MATLAB實務設計	3 3	JAVA程式設計認證	3 3	人工智慧	3 3						
	網路工程師認證	3 3	影像處理	3 3								
	軟體工程實務	3 3	新產品開發管理與專利保護	3 3								
			資訊安全導論	3 3								
			書報討論	2 2								
			計算機圖學		3 3							
			網路程式設計		3 3							
			專案管理理論與實務		3 3							
		無線網路		3 3								
專業選修小計	R1綜合專業學程+R2實務專業學程，或R1綜合專業學程+R3學術專業學程二類二選一，共46學分。											

附件	一年級		二年級		三年級		四年級		上學期		下學期	
	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數

學期總計 至少133學分。

課程說明：

- 「跨科技領域知識(一)(二)(三)」由以下課程中選擇三門  
 資管類：健康生活App體驗與設計(3)(大三上)、健康生活互動網站應用(3)(大三下)  
 電商類：雲端知識與生活科技(3)(大二下)、健康生活產業網路行銷(3)(大三上)  
 生技類：健康醫學概論(3)(大二下)、生技產業與市場(3)(大三下)
- 微積分、資料結構、專題均為全學年課程，若第一學期未修或修課成績未達 50分者，不可選修第二學期的課程。
- 計算機程式設計未修或修課成績未達50分者，不可選修物件導向程式設計。
- 二類跨領域就業導向學程(資訊技術應用類、健康生活科技應用類)可二選一。
- R1(網路、多媒體與晶片應用基礎學程)學生須修滿25學分，才能視為取得此學程。  
 R2(晶片應用進階學程)學生須至少任選 7 門課共21學分，才能視為取得此學程。  
 R3(網路與多媒體進階學程)學生須至少任選 7 門課共21學分，才能視為取得此學程。
- 主修領域一 晶片應用：系核心學程+R1基礎學程+R2晶片應用進階學程，合計69學分。  
 主修領域二 網路與多媒體：系核心學程+R1基礎學程+R3網路與多媒體進階學程，合計69學分。
- 學生因特殊情況欲於當學期加修學分而超過該學期之學分上限，則該學生前一學期學業成績需排名在其班級之前10%。
- 畢業前須考取CCNA證照或JAVA證照等等學力，否則須加修業2門系專業選修（共6學分）。
- 專業選修學程之課程會視該學期本系開課空間與時間、師資之專長與屬性予以彈性增減。